

APPENDIX B

推奨ランド寸法

Recommended Pad Dimensions

■標準ランド寸法 Standard Soldering Pad Dimensions

はんだ付け時の最適ランド寸法は条件によって異なりますが、標準的には次のランド寸法を推奨致します。

The optimum dimension of soldering pad at the time of soldering differs according to conditions, however, the following pad dimensions are recommended as standard.

■角形チップ部品 Flat Type Components

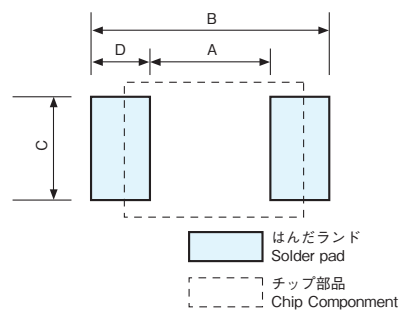
●リフローはんだ用 For Reflow Soldering

形名 Type	形状 Style	寸法 Dimensions (mm)				
		部品サイズ Component Size	A	B	C	D
RK73	1F	0.4×0.2	0.12	0.48	0.18	0.18
HV73	1H	0.6×0.3	0.25	0.7	0.3	0.225
SG73	1E	1.0×0.5	0.5	1.3	0.3	0.4
SR73	1J	1.6×0.8	1.0	2.0	0.6	0.5
LT73	2A	2.0×1.25	1.3	2.5	1.05	0.6
NT73	2B	3.2×1.6	2.2	4.0	1.4	0.9
PT72	2E	3.2×2.5	2.2	4.0	2.3	0.9
LA73	W2H/2H	5.0×2.5	3.3/3.5	6.1/6.3	2.3	1.4
LP73	W3A・3A	6.3×3.1	4.6	8.0	3.0	1.7
SDT73	1E	1.0×0.5	0.5	1.8	0.5	0.65
RF73	1J	1.6×0.8	0.5	2.5	0.9	1.0
KL73	2A	2.0×1.25	0.8	3.4	1.3	1.3
UR73 UR73D UR73V	2B	3.2×1.6	1.2	4.6	1.8	1.7
	2H(10mΩ~30mΩ)	5.0×2.5	1.8	6.1	2.6	2.15
	2H(33mΩ~100mΩ)	5.0×2.5	3.3	6.1	2.5	1.4
	3A(10mΩ~30mΩ)	6.3×3.1	2.3	8.0	3.3	2.85
	3A(33mΩ~100mΩ)	6.3×3.1	4.6	8.0	3.2	1.7
	2B(10m~13m)	3.2×1.6	0.7	4.4	1.6	1.85
UR73VD	2B(15m~16m)	3.2×1.6	0.9	4.4	1.6	1.75
	2B(18m~20m)	3.2×1.6	1.0	4.4	1.6	1.7
	2B(22m~27m)	3.2×1.6	1.1	4.4	1.6	1.65
	2B	1.6×3.2	0.7	2.3	3.2	0.8
WK73 WU73	2H	2.5×5.0	1.0	3.5	5.0	1.25
	2J	3.1×4.6	1.6	3.9	4.6	1.15
	3A	3.1×6.4	1.6	3.9	6.3	1.15
TF	10B	1.0×0.5	0.5	1.3	0.3	0.4
	16S, 16A, 16V	1.6×0.8	1.0	2.0	0.6	0.5
PS	J(0.5mΩ)	10.0×5.2	5.6	11	6.2	2.7
	J(1mΩ)	10.0×5.2	5.6	11	6.2	2.7
	G(0.5mΩ)	6.9×6.6	個別ページに記載			
	G(1mΩ)	6.9×6.6	個別ページに記載			
	B(0.2mΩ)	10.0×8.4	2.2	10.8	9.0	4.30
	B(0.75mΩ)	10.0×8.4	2.8	10.7	8.9	3.95
	B(1mΩ)	10.0×8.4	3.8	10.7	8.9	3.45
TLR	I	10.0×5.2	5.6	11.0	6.2	2.7
	E	6.4×6.4	1.4	7.6	7.0	3.1
	1E	1.0×0.5	0.2	1.3	0.6	0.55
	2A	2.0×1.25	0.5	2.5	1.3	1.0
	2BN, 2B, 2BW(1mΩ)	3.2×1.6	0.8	4.0	1.8	1.6
	2BN, 2B, 2BW(2mΩ~20mΩ)	3.2×1.6	1.4	4.0	1.8	1.3
	2H・2HW(1mΩ)	5.0×2.5	1.0	6.1	3.0	2.55
	2H・2HW(2mΩ~6mΩ)	5.0×2.5	1.3	6.1	3.0	2.4
	2H・2HW(7mΩ~10mΩ)	5.0×2.5	3.3	6.1	3.0	1.4
	3A(1mΩ)	6.35×3.18	1.45	7.55	3.83	3.05
	3A(2mΩ)	6.35×3.18	3.45	7.55	3.83	2.05
	3A(3mΩ)	6.35×3.18	2.15	7.55	3.83	2.7
	3A(4mΩ)	6.35×3.18	3.45	7.55	3.83	2.05
	3AW(0.5mΩ~0.82mΩ)	6.35×3.18	0.8	7.55	3.83	3.375
	3AW(1mΩ~4mΩ)	6.35×3.18	1.45	7.55	3.83	3.05
	3AW(5mΩ~8mΩ)	6.35×3.18	3.45	7.55	3.83	2.05
	3AW(9mΩ, 10mΩ)	6.35×3.18	4.4	7.55	3.83	1.575
	3AP(0.5mΩ~0.82mΩ)	6.35×3.18	0.8	7.55	3.83	3.375
3AP(1mΩ)	6.35×3.18	1.45	7.55	3.83	3.05	
3AP(2mΩ)	6.35×3.18	1.05	7.55	3.83	3.25	
3AP(3mΩ~4mΩ)	6.35×3.18	1.45	7.55	3.83	3.05	
3AP(5mΩ~8mΩ)	6.35×3.18	3.45	7.55	3.83	2.05	
3AP(9mΩ, 10mΩ)	6.35×3.18	4.4	7.55	3.83	1.575	
TLRH	2A	2.0×1.25	0.5	2.5	1.3	1.0
	3AW	6.3×3.2	4.4	7.5	3.7	1.55
	3AP	6.3×3.2	2.15	7.55	3.83	2.7
TLRZ	1J	1.6×0.8	0.5	2.0	0.9	0.75
	2A	2.0×1.25	0.5	2.5	1.45	1.0
2B	3.2×1.6	2.2	3.8	1.8	0.8	
	6.3×3.1	3.4	8.0	3.0	2.3	
07, W07	5.0×2.5	2.3	7.0	2.6	2.35	
	1, W1	6.3×3.1	3.4	8.0	3.0	2.3
SL	2	11.5×7.0	5.4	15.0	5.0	4.8
	2, 3, 5	11.5×7.0	5.0	15.0	6.0	5.0
LFC, KL	32	3.2×2.5	2.2	5.0	2.0	1.4
	0402	1.0×0.5	0.46	1.18	0.66	0.36
KQT KQ KQC	0603	1.6×1.0	0.8	2.0	1.02	0.6
	0805	2.0×1.5	0.76	2.8	1.78	1.02
	1008	2.5×2.2	1.27	3.31	2.54	1.02
CCF	1N	6.0×2.5	3.0	7.2	2.8	2.1
	1F	6.1×2.5	3.2	8.8	3.75	2.8
CCP	2E	3.2×2.5	2.2	5.0	2.0	1.4
	2B	3.2×1.6	2.2	5.0	1.4	1.4
NV73 NV73DL	1H	0.6×0.3	0.25~0.35	0.65~0.95	0.25~0.35	0.2~0.3
	1E	1.0×0.5	0.51	1.73	0.51	0.61
	1J	1.6×0.8	1.0	3.0	1.0	1.0
	2A	2.0×1.25	1.2	4.0	1.2	1.4
	2B	3.2×1.6	2.2	5.0	1.3	1.4
	2E	3.2×2.5	2.2	5.0	2.2	1.4
	2J	4.5×3.2	3.0	5.8	2.9	1.4
NV73DS	2L	5.7×5.0	4.5	7.5	4.7	1.5
	2L	6.1×5.1	4.5	7.5	4.7	1.5

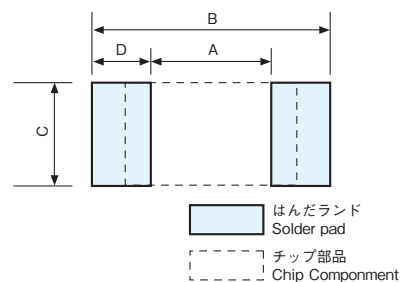
●フローはんだ用 For Flow Soldering

形名 Type	形状 Style	寸法 Dimensions (mm)				
		部品サイズ Component Size	A	B	C	D
RK73	1E	1.0×0.5	0.5	1.5	0.5	0.5
HV73	1J	1.6×0.8	1.0	2.4	0.8	0.7
SG73	2A	2.0×1.25	1.3	3.1	1.25	0.9
SR73	2B	3.2×1.6	2.2	4.4	1.6	1.1
LT73	2E	3.2×2.5	2.2	4.4	2.5	1.1
NT73	W2H/2H	5.0×2.5	3.3/3.5	6.1/6.3	2.5	1.4
LA73	W3A・3A	6.3×3.1	4.6	8.0	3.2	1.7
LP73	1E	1.0×0.5	0.5	1.8	0.5	0.65
SDT73	1J	1.6×0.8	0.5	2.5	0.9	1.0
RF73	2A	2.0×1.25	0.8	3.4	1.3	1.3
KL73	2B	3.2×1.6	1.2	4.6	1.8	1.7
UR73 UR73D UR73V	2H(10mΩ~30mΩ)	5.0×2.5	1.8	6.1	2.6	2.15
	2H(33mΩ~100mΩ)	5.0×2.5	3.3	6.1	2.5	1.4
	3A(10mΩ~30mΩ)	6.3×3.1	2.3	8.0	3.3	2.85
	3A(33mΩ~100mΩ)	6.3×3.1	4.6	8.0	3.2	1.7
	2B(10m~13m)	3.2×1.6	0.7	4.4	1.6	1.85
	2B(15m~16m)	3.2×1.6	0.9	4.4	1.6	1.75
UR73VD	2B(18m~20m)	3.2×1.6	1.0	4.4	1.6	1.7
	2B(22m~27m)	3.2×1.6	1.1	4.4	1.6	1.65
	2B	1.0×0.5	0.5	1.5	0.5	0.5
	16S, 16A	1.6×0.8	1.0	2.4	0.8	0.7
NV73 NV73DL	1J	1.6×0.8	1.0	3.0	1.0	1.0
	2A	2.0×1.25	1.2	4.0	1.2	1.4
	2B	3.2×1.6	2.2	5.0	1.3	1.4
	2E	3.2×2.5	2.2	5.0	2.2	1.4
NV73DS	2J	4.5×3.2	3.0	5.8	2.9	1.4
	2L	5.7×5.0	4.5	7.5	4.7	1.5
CCF	2L	6.1×5.1	4.5	7.5	4.7	1.5
	1F	6.1×2.5	3.2	8.8	3.75	2.8

●リフローはんだ用 For Reflow Soldering



●フローはんだ用 For Flow Soldering



※これらの推奨ランド寸法は標準パターンで、特性を保証するものではありません。事前に御確認の上御使用ください。

These pad dimensions are only for standard pattern and the characteristics are not guaranteed, which you are suggested to confirm before use.

本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。ご注文およびご使用前に納入仕様書で内容をご確認ください。

車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器へのご使用を検討される場合には、必ず事前にご相談ください。

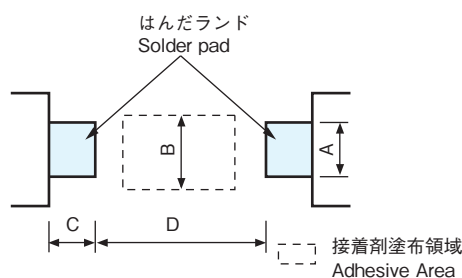
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

Contact our sales representatives before you use our products for applications including automobiles, medical equipment and aerospace equipment.

Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.

■メルフタイプ部品 Melf Type Components

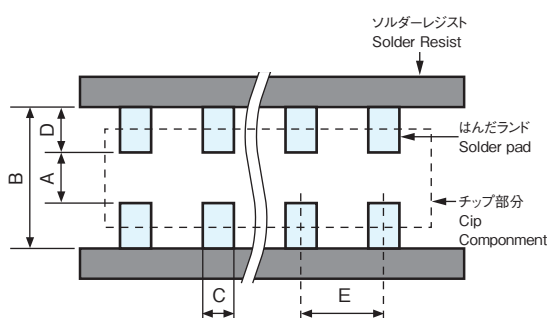
- フローはんだ用 For Flow Soldering



形名 Type	形状 Style	寸法 Dimensions (mm)				
		部品サイズ Component Size	A	B	C	D
RD41 RN41	2A・10	2.0×1.25	1.3	1.3	2.0	1.3
	2ES・12M	3.5×1.40	1.5	2.2	1.5	2.0
RM41	2D・20	3.2×1.55				
MLT	2E・25	5.9×2.2	2.0	3.0	3.0	4.0
CC	2H					

■チップネットワーク Chip Networks

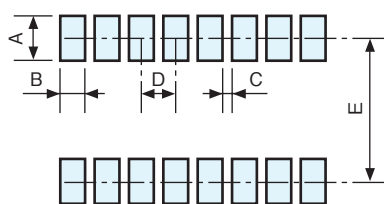
- リフローはんだ用 For Reflow Soldering



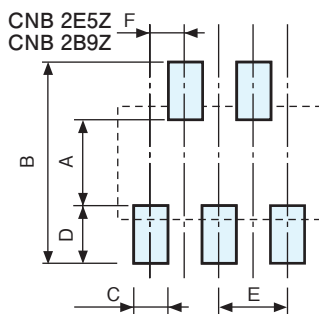
形名 Type	形状 Style	寸法 Dimensions (mm)					
		部品サイズ*1 Component Size	A	B	C	D	E
CN	1E2K	1.0×1.0	0.5	1.5	0.4	0.5	0.67
	1E4K	2.0×1.0			0.3		0.5
	1JA/K	(0.8×n)×1.6	1.0	2.6	0.4	0.8	0.8
	1F8K	3.8×1.6	1.0	3.0	0.3	1.0	0.5
	2B4A	5.1×3.1	2.1	4.1	0.9	1.0	1.27
	1E	(0.5×n)×1.0	0.5	1.5	0.3	0.5	0.5
	1J	(0.8×n)×1.6	0.8	2.6	0.4	0.9	0.8
	2A	(1.27×n)×2.0	1.0	3.0	0.65	1.0	1.27
CND	2B	(1.27×n)×3.2	2.2	4.2	0.65	1.0	1.27
	1J10K	3.2×1.6	0.9	2.6	0.4	0.85	0.64
CNN	2B10	6.4×3.1	2.1	4.1	0.6	1.0	1.27
	2A2	2.54×2.0	1.2	2.8	0.6	0.8	1.27

*1 n: 素子数 n: Number of Resistors

MRGF16



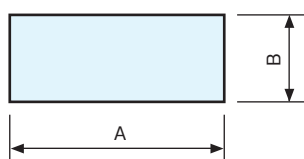
形名 Type	寸法 Dimensions (mm)					
	部品サイズ Component Size	A	B	C	D	E
MRGF16	11.0×7.7	1.27	0.76	0.51	1.27	7.62



形名 Type	寸法 Dimensions (mm)							
	部品サイズ Component Size	A	B	C	D	E	F	G
CND 1J10Y	3.2×1.6	0.9	2.3	0.3	0.7	0.635	2.45	0.4
CND 2A10Y	4.0×2.1	1.0	3.0	0.4	1.0	0.8	3.4	0.4
CNB 2E5Z	3.2×2.5	1.7	3.9	0.5	1.1	1.0	0.5	—
CNB 2B9Z	6.4×3.2	2.4	4.6	0.5	1.1	1.3	0.65	—

■その他 Others

- リフローはんだ用 For Reflow Soldering



形名 Type	寸法 Dimensions (mm)	
	A	B
RCS	4.1~4.3	1.4~1.6
RCT	2.9~3.1	1.05~1.25
RCU	2.5~2.7	0.6~0.8
RCW	4.1~4.3	1.4~1.6

※これらの推奨ランド寸法は標準パターンで、特性を保証するものではありません。事前にご確認の上ご使用ください。

These pad dimensions are only for standard pattern and the characteristics are not guaranteed, which you are suggested to confirm before use.